

证券简称：胜宏科技

证券代码：300476

上市地点：深圳证券交易所



**胜宏科技（惠州）股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告**

二〇二四年十一月

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”或“胜宏科技”）为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，拟向特定对象发行 A 股股票募集资金。公司董事会对本次发行募集资金使用的可行性分析如下：

（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义）

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 198,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟用本次募集资金投入
1	越南胜宏人工智能 HDI 项目	181,547.67	90,000.00
2	泰国高多层印制线路板项目	140,207.90	50,000.00
3	补充流动资金和偿还银行贷款	58,000.00	58,000.00
合计		379,755.57	198,000.00

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自有或自筹资金解决；为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

二、募集资金使用的必要性及可行性

（一）越南胜宏人工智能HDI项目和泰国高多层印制线路板项目

1、项目概况

越南胜宏人工智能 HDI 项目预计总投资 181,547.67 万元，拟使用募集资金 90,000.00 万元，建设期 3 年，第三年开始分步投产，至第五年全部达产。本项目的实施主体为全资子公司 VICTORY GIANT TECHNOLOGY (VIETNAM) CO.,LTD，地点位于越南北宁省，拟建设生产人工智能用高阶 HDI 产品，计划年产能 15 万平方米。

泰国高多层印制线路板项目预计总投资 140,207.90 万元，拟使用募集资金

50,000.00 万元，建设期 2 年，第三年全部达产。本项目的实施主体为全资子公司 APCB Electronics (Thailand) Co.,Ltd.，地点位于泰国大城府，拟建设生产服务器、交换机、消费电子等领域用高多层 PCB 产品，计划年产能 150 万平方米。

2、项目建设的必要性

(1) 全球化战略释放增长驱动力，公司需进一步深化布局

随着公司业务规模的扩大，以及客户等级的结构性提升，全球化战略势在必行。近年来，全球化成为公司的核心发展战略之一，也是当下实现新的跨越式发展的必要举措。

经过长期研判和探索，公司于 2023 年收购全球领先的软板制造商 MFS 集团，完成全球化布局的第一个里程碑，打造了良好的协同效应。未来，公司需要进一步深化全球化布局，在海外市场做精做细，与上下游国际知名企业联合开展技术研发和产业化应用，在国际市场打造领先的研发和交付能力。

越南项目聚焦高速成长的人工智能赛道，拟投资业内领先的先进制程装备，生产人工智能 AI 服务器及终端、GPU 芯片、高频高速传输等应用领域的高阶 HDI 产品。泰国项目主要布局多层板，目标应用领域包括服务器、交换机、汽车电子、消费电子等，满足客户对高端多层板的海外交付要求。

(2) 客户高度重视公司海外布局及实施时间表

伴随胜宏科技国际竞争力的增强，客户等级显著提升，客户结构整体升级，成功进入英伟达、AMD、英特尔、特斯拉、微软、博世、亚马逊、谷歌、台达等国际知名企业的供应链，构成了公司最核心的客户群。优质国际客户的认可，使得公司在宏观经济和行业景气度波动期间均实现了稳健的业绩，为全体股东创造回报。优质国际客户是公司未来发展的重要驱动力之一。

随着合作广度和深度不断增强，国际客户纷纷要求公司参与其全球供应网络，建立全球化交付配套能力，以满足其在国际市场的订单需求；且客户对公司建立海外布局的时间要求非常迫切，高度重视实施时间表。若未能按期建立全球化配套能力，则公司将面临错失业务机会的风险，不利于长期发展。

(3) 人工智能推动电子行业创新，高端 PCB 产品需求对技术和装备升级提出要求

随着人工智能技术和应用的快速发展，未来五年 AI 系统、服务器、存储、网络设备等是 PCB 需求增长的主要动能。随着 AI 服务器的升级，GPU 主板也将由高多层板逐步升级为 HDI，因此 HDI 将是未来 5 年增速最快的 PCB 产品，特别是 4 阶以上的高阶 HDI 产品需求增速快。

随着服务器平台的升级，服务器 PCB 持续向更高层板发展，对技术和装备的升级提出要求。对应于 PCIe3.0 的 Purely 服务器平台一般使用 8-12 层的 PCB 主板；PCIe4.0 的 Whitley 平台则要求 12-16 层的 PCB 层数；对于未来将要使用 PCIe5.0 的 Eagle Stream 平台而言，PCB 层数需要达到 16-18 层以上。根据 Prismark 数据 18 层以上 PCB 单价约是 12-16 层价格的 3 倍。

针对高速增长的高阶 HDI 和高多层板和等高端产品需求，公司需着力布局先进技术和装备，以满足核心战略客户的要求。

3、项目建设的可行性

（1）人工智能 AI 催生 PCB 行业增长新动能

受益于人工智能 AI 算力基建带来的服务器、交换机需求高速增长，以及 AI 开启的消费电子终端创新周期，HDI、层数较高的高多层板等高端品需求快速增长，PCB 行业景气度持续上行，Prismark 预计 2024 年全球 PCB 产值将恢复增长，相较 2023 年同比下降 14.9% 显著改善。而 HDI 将成为 AI 服务器相关 PCB 市场增速最快的品类，根据 Prismark 预计，2023-2028 年 HDI 的年均复合增速达到 16.3%。

Prismark 预测，2024 年全球 AI 服务器出货金额将达到 280 亿美元，同比增长 16%，其中，高阶 AI 服务器出货量增速将达到 128%。其中，英伟达占据了 AI 服务器 GPU 主导地位，预计 2024 年将出货 690 万颗 GPU，增速达到 82%。以现有核心战略客户合作为基础，公司重点聚焦 AI 服务器领域的高端产品需求，市场前景可观。

（2）东南亚布局成为行业趋势，产业链聚集效应逐渐形成

自 2006 年超越日本成为全球第一大 PCB 生产国开始，我国 PCB 产能已占据全球产能的一半以上。目前，东南亚投资布局成为 PCB 行业的新发展趋势。全球排名前列的 PCB 厂商基本均在东南亚投资布局，以泰国、越南等为代表的

东盟国家的 PCB 产业集群逐渐形成。

近年来，泰国和越南承接了较多的电子信息行业企业的产能转移，产业集群快速发展，吸引了惠普、索尼、松下、三星、LG、西门子等终端品牌厂商，广达、UMC Electronics、Celestica、Sanmina 等组装厂，以及莫仕、台达、村田等各类元器件制造商，其中很多企业为胜宏科技现有客户。下游客户在东南亚的布局，以及与胜宏科技的紧密合作，为本次募集资金投资项目的顺利实施奠定了坚实基础。

（3）公司技术实力和客户拓展能力持续提升

公司依托省级新型研发机构、省级工程研发中心和企业技术中心等研发平台，自上市以来，围绕 PCB 核心技术累计投入研发近 20 亿元，拥有线路板领域有效专利超 400 项，研发团队人员超 1300 名，建立了以基础材料为起点，到工艺、设备的全产业链技术能力。公司高精密多层线路板的量产技术能力达 70 层，高密度互连 HDI 板的量产技术能力达 24 层六阶。

随着技术实力的提升，公司的客户群体持续升级，成功进入英伟达、AMD、英特尔、特斯拉、微软、博世、亚马逊、谷歌、台达等国际知名企业的供应链，优质的核心客户群体驱动公司订单需求的增长。

（4）随着综合实力的提升，公司的国际化运营能力渐趋成熟

2023 年 11 月收购 MFS 集团后，公司全方位赋能标的公司发展，整合效果良好，协同效应显著，2024 年上半年，MFS 集团营业收入同比增长 13%，净利润同比增长 104%，其中，二季度收入创历史新高。

随着国际化战略的持续贯彻实施，公司的国际化运营能力持续提升，建立起较为成熟的人才团队、管理体系和海外运营能力，结合现有优质大客户资源，具备充足的海外项目实施能力。

（5）印制线路板（PCB）行业发展得到国家政策大力支持

作为电子产品中重要的基础载体，PCB 产业是国家重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，受到国家政策大力支持。“十四五规划”中提出要加快壮大新一代信息技术、新能源汽车等产业，国务院及相关部委随后推出了《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》、《5G 应用“扬帆”行动计划

《（2021-2023 年）》、《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》、《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）》、《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）》等一系列产业政策和引导 5G 通信、新能源汽车、物联网、工业互联网等领域的发展。这为 PCB 行业的未来发展带来了积极的影响，不断推动行业发展。

（二）补充流动资金和偿还银行贷款项目

1、项目概况

公司计划将本次募集资金中的 58,000.00 万元用于补充流动资金和偿还银行贷款，由母公司胜宏科技（惠州）股份有限公司实施，以优化公司财务结构，从而提高公司的抗风险能力和持续盈利能力。

2、项目的必要性

（1）补充营运资金满足公司业务快速发展的需求

随着横向并购战略的实施，以及 AI 算力、AI 服务器等高技术领域蓬勃发展，公司的收入和利润规模快速增长，未来几年仍将大力投入研发，面向国家重大战略需求，抢先布局 AI 算力、GPU 芯片等领域，筑牢技术优势，抢抓发展机遇，需要大量的营运资金。

报告期内，公司营运资金缺口主要通过向银行贷款的方式解决，导致财务费用增加。通过本次发行募集资金补充流动资金，公司的营运资金将得到补充，抗风险能力将进一步增强。

（2）改善资产负债结构，提升财务健康度水平

2021 年末至 2024 年 9 月末，公司资产负债率、流动比率、速动比率情况如下：

项目	2024-09-30	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
资产负债率	53.65%	56.13%	51.50%	53.42%
流动比率	1.01	0.96	0.93	0.95
速动比率	0.78	0.78	0.75	0.71

因并购贷款等因素所致，公司 2023 年度有息负债增加较多，一方面，相关财务费用影响公司业绩，另一方面，公司核心战略客户高度重视供应商的财务健康度，要求公司持续提升负债结构、现金流、盈利能力等方面的健康度水

平，财务健康度水平直接影响公司与战略客户的合作。通过本次融资，公司的资产负债结构将得到改善，财务健康度水平将提升，避免因负债率过高而影响与核心战略客户的合作。

3、项目的可行性

（1）本次发行的募集资金使用符合相关法律法规的规定

本次向特定对象发行股票的募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款符合相关法律法规的规定，具备可行性。募集资金到位后，可进一步改善资本结构，降低财务风险，有效缓解公司经营活动扩张的资金需求压力，确保公司业务持续、健康、快速发展，符合公司及全体股东利益。

（2）公司已建立完善的募集资金使用管理制度并有效运行

公司依据中国证监会、深交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，建立了较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序，并在日常生产经营过程中不断地改进和完善。

公司已根据相关规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用等进行了明确规定。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目围绕高技术应用领域展开布局，面向人工智能 AI 服务器及终端、GPU 芯片等国家战略需求，符合国家相关的产业政策，项目的实施有利于促进公司现有主营业务的持续健康发展，在国际市场打造领先的研发和交付能力，深度参与英伟达等国际客户的全球供应网络，进一步提高公司的核心竞争力和国际化运营能力，符合公司长远发展战略。本次募集资金投资项目实施后将进一步提升公司盈利能力，巩固并提高公司在行业内的地位，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

1、增大公司总资产与净资产规模

本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模将同时增大，资本结构将得到优化，资金实力将大幅提升，财务费用有望得到节降，为公司后续发展提供有力保障。

2、改善资产负债结构，提升财务健康度水平

本次发行完成后，公司的资本金得到进一步充实，资产负债结构优化，偿债能力将显著提高，财务健康度水平将有效提升。

四、募集资金使用可行性分析结论

本次向特定对象发行股票的募集资金使用计划符合公司的战略发展规划，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金的使用，是公司面向国家战略需求，布局高技术应用领域的必要路径，也是抢抓重大战略机遇，培育新质生产力的重要举措，有利于公司高质量发展，提升国际化竞争力，同时可以满足公司快速发展的营运资金需求，提升财务健康度水平，符合公司及全体股东的利益，本次向特定对象发行募集资金是必要且可行的。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2024年11月7日